

中国国际金融股份有限公司

关于希荻微电子集团股份有限公司

2025 年度持续督导跟踪报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求对希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“希荻微”或“公司”）进行持续督导，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与希荻微签订保荐协议，已明确双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	希荻微在本持续督导跟踪报告期间未发生按相关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	希荻微在本持续督导期间内未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期及不定期回访等方式，了解希荻微业务经营情况，对希荻微开展持续督导工作

6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	在本持续督导期间，保荐机构督导希荻微及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促希荻微依照相关规定进一步健全和完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对希荻微的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，希荻微的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促希荻微进一步完善信息披露制度并严格执行，审阅其信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对希荻微的信息披露文件进行事前或事后的及时审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	在本持续督导期间，希荻微及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在上述事项的情况
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，希荻微及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，经保荐机构核查，希荻微不存在应及时向上海证券交易所报告的情况

14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	在本持续督导期间，希荻微未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已完成 2025 年度对希荻微的现场检查
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	在本持续督导期间，希荻微不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2025 年度，公司不存在需要整改的情况。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

2025 年，公司实现营业总收入 93,943.50 万元，较上年同期上升 72.21%；实现归属于母公司所有者的净亏损 11,391.86 万元，亏损金额较上年同期减少 17,667.88 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损 11,871.97 万元，亏损金额较上年同期减少 18,148.51 万元。

受市场情况及音圈马达驱动芯片产品线部分产品生产调整为自主委托和传感器芯片产品线持续贡献的影响，公司营业总收入较 2024 年大幅增加；同时，公司业务规模的不断扩大、产品矩阵日益丰富及供应链整合优化带动毛利润的提升以及存货减值风险缓释使得资产减值损失的减少，综合推动公司亏损大幅收窄。为长远发展，

公司持续在汽车、计算和存储等应用领域布局，期间费用尤其是研发投入占营业收入的比重较大，且公司综合毛利率仍有进一步提升空间，使得公司 2025 年仍处于亏损状态。

公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。半导体行业具有较强的周期性特征，与国内外宏观经济的周期性波动息息相关，公司所属行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。如果后期出现技术研发失败、下游终端市场需求持续下降、市场竞争加剧、宏观景气度下行、国家产业政策变化、公司客户拓展情况不及预期等情形，公司营业收入和净利润可能面临持续下滑或亏损的风险。未来，公司将持续提升产品竞争力及运营管理能力以应对上述可能出现的不利因素。

（二）核心竞争力风险

公司核心竞争力风险主要包括人才储备不足及高端人才流失的风险、产品研发及技术创新的风险以及核心技术泄密风险。

1、人才储备不足及高端人才流失的风险

半导体及集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，对于研发人员尤其是核心技术人才的依赖远高于其他行业，研发人员的产品设计能力对公司的行业地位与客户认可度存在直接影响。作为以技术为核心驱动力的创新性企业，公司近年来的快速发展得益于搭建的高素质人才队伍。

随着业务规模快速增长、产品覆盖日益广泛，公司需要不断培育和招纳优秀人才，扩充专业人才梯队，以实现研发实力的稳步提升。然而，随着集成电路设计行业规模的不断增长，新的市场参与者不断涌现，集成电路企业对核心人才的争夺日趋激烈。如果公司未能建立有效的人才培育与激励体系，或缺乏对新人才的吸引力，则面临人才储备不足及高端人才流失的风险，将对公司新产品研发能力和市场拓展能力造成不利影响，从而在一定程度上削弱公司的核心竞争力。

2、产品研发及技术创新的风险

公司推出的电源管理芯片及信号链芯片等集成电路产品主要应用于智能手机和可穿戴设备等消费电子领域和汽车电子领域。公司需对客户诉求、行业发展趋势、

市场应用特点等保持深刻的理解，并持续进行较大规模的研发投入，及时将研发创新成果转化为成熟产品推向市场。

然而，集成电路产品的研发设计需要经过产品定义、开发、验证、流片、测试等多个环节，需要一定的研发周期并存在研发失败风险。若公司未来产品研发不能跟上行业升级水平，创新方向不能与客户的需求相契合，或新产品研发不及预期，将带来产品市场认可度下降、研发资源浪费并错失市场发展机会等风险，进而对公司的经营效率和效果产生不利影响。

3、核心技术泄密风险

公司所处行业属于技术密集型行业，技术实力的竞争是企业竞争的核心。为保障经营过程中所积累多项专利及专有技术的保密性与安全性，公司通过严格执行研发全过程的规范化管理、申请集成电路布图设计专有权及发明专利保护等相关措施避免技术泄密。此外，公司还与主要技术人员签订了保密合同，防范核心技术机密的外泄。

然而，上述体系不能完全排除因个别技术人员违反职业操守而泄密或者公司内控制度出现技术漏洞的情况，一旦核心技术失密，将可能使公司部分或完全丧失技术竞争优势，给公司市场竞争力和生产经营带来负面影响。

（三）经营风险

公司的经营风险主要来源于 Fabless 经营模式、产品质量、客户和供应商集中度较高、原材料成本波动以及扩大规模带来的管理挑战等因素。

1、Fabless 经营模式风险

目前，公司主要采用 Fabless 经营模式，专注于芯片的研发、设计与销售环节，将晶圆制造与封装测试环节交由代工厂进行委外生产。在该经营模式下，晶圆制造及封装测试厂商的工艺水平、生产能力、产品质量、交付周期等因素均对公司产品的销售存在一定影响。

在半导体产业供需关系波动的影响下，若上游晶圆制造产能出现紧缺，上游供应商出现提价、产能不足的情形，将对公司毛利水平和产品交付的稳定性存在一定

影响。此外，若上游的晶圆代工厂、封装测试厂等企业出现突发经营异常，或者与公司的合作关系出现不利变化，公司可能面临无法投产、无法交货等风险。

2、产品质量风险

由于芯片产品具有高度复杂性，如果未来公司在产品持续升级迭代、新产品开发过程中不能达到客户质量标准，或上游产品生产出现质量及可靠性问题，可能会对公司产品正常的产品供应、客户合作关系及市场形象带来一定不利影响，从而有碍持续经营与盈利。

3、客户和供应商集中度较高以及大客户流失的风险

公司终端客户主要包括手机产业链和汽车产业链的品牌厂商，终端市场集中度相对较高，导致公司的客户集中度较高。未来，若公司主要客户或终端品牌厂商的经营情况和资信状况发生重大不利变化，或主要客户经营、采购战略发生较大变化，公司将面临大客户流失的风险。

公司供应商主要包括晶圆制造厂和封装测试厂，由于晶圆制造及封测代工业务的市场格局相对集中，公司向前五大供应商合计采购的金额占同期采购金额占比相对较高。若公司的主要供应商业务经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张，可能导致供应商不能足量及时出货，对公司整体经营产生不利影响。

4、原材料及代工价格波动风险

受到宏观经济环境变化的影响，全球上游原材料及关键贵金属价格攀升，导致芯片行业晶圆代工与封测成本上涨。尽管全球半导体市场处于调整期，但受益于电动汽车、新能源、工业控制等领域的强劲需求，成熟制程产能持续紧张，利用率保持高位，供需错配使得公司采购的主要产品及服务价格也随之存在波动。未来，若全球产能供给持续吃紧导致价格上升，或因贸易环境变化导致公司主要原材料及代工服务价格发生大幅波动，将可能拉升公司的成本，从而对公司整体经营造成不利影响。

5、公司规模扩大带来的管理风险

基于业务发展需要和未来战略规划，公司通过技术收购、股权并购等方式，横

向拓展公司的业务，促使业务规模、人员队伍等持续扩大。随着规模的扩张，公司在组织设置、内部控制、团队管理激励、供应链及销售渠道整合、财务规范建设、企业文化融合等经营管理层面，面临诸多挑战，这对公司管理层的综合素质及管理能力的要求更高，如若公司内部人才及综合管理能力不能适应公司规模迅速扩张的需要，将引发一定的管理风险。

6、存在影响募投项目按计划实施的障碍或进展不及预期的风险

由于公司总部基地建设项目所在地块属于城市轨道交通安全保护区，所涉及政府规划、审批等前置必备程序较多及流程较长，公司直至 2024 年 1 月方取得《建筑工程施工许可证》，并正式开工建设。虽然公司积极推进总部基地和前沿技术研发项目的进展，但受到政府规划、审批流程等外部因素的影响，公司总部基地和前沿技术研发项目存在无法按照计划实施或进展不及预期的风险，公司将按照相关程序履行决策程序，并及时履行信息披露义务。

7、并购整合风险

公司完成收购诚芯微 100% 股权后，公司业务范围在扩大的同时，在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临整合风险。公司能否提高诚芯微的竞争优势并充分发挥协同效应，是公司收购完成后面临的管理风险。公司将进一步做好子公司融合工作，推进管理制度、流程的融合，加强内部控制与子公司管理制度建设；保持管理团队、核心技术人员稳定性；进行团队和企业文化建设，建立健全人才培养、培训机制，营造良好企业发展氛围。

（四）财务风险

公司财务风险主要包括毛利率波动风险、收入季节性波动风险、存货跌价风险以及汇率波动风险。

1、毛利率波动风险

随着行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化，或公司技术实力停滞不前，或公司未能有效控制产品成本，或公司产品市场竞争格局发生变化等将导致公司发生产品售价下降、产品收入结构向低毛利率产品倾斜等不利情形，不排除公司综合

毛利率水平波动甚至出现下降的可能性，给公司的经营带来一定风险。

2、收入季节性波动风险

公司产品主要应用于智能手机和可穿戴设备等消费电子领域和汽车电子领域，由于下游应用市场的需求存在季节性波动，公司营业收入存在季节性波动的风险，这对公司经营管理水平提出了较高的要求。

3、存货跌价风险

由于公司产品主要应用于智能手机和可穿戴设备等消费电子领域和汽车电子领域，移动终端智能电子产品的更迭较快，如果未来因客户需求变化、公司未能准确判断下游需求等原因使得公司存货无法顺利销售，或出现市场竞争加剧、公司产品性能缺少竞争优势等情形使得产品价格大幅下跌，将存在进一步计提存货减值准备的风险。

4、汇率波动风险

随着公司业务的持续扩张，境外经营主体业务规模可能进一步扩大，如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，将造成公司经营业绩及所有者权益的波动。

（五）行业风险

公司产品主要应用于智能手机和可穿戴设备等消费电子领域和汽车电子领域。智能手机市场的繁荣程度及出货量直接影响智能手机品牌客户对公司芯片的采购需求。若未来智能手机市场需求出现下滑，导致公司出货量减少，且公司在其他领域的业务拓展未能达到预期，这将对公司的营业收入和净利润产生不利影响。除此之外，市场竞争日趋激烈，或将加剧公司面临的行业风险，对公司未来经营业绩产生不利影响。

（六）宏观环境风险

近年来，全球贸易政策的变化导致了国际贸易摩擦的加剧，这为公司所在行业的发展带来了一定的不确定性。在贸易摩擦的背景下，我国集成电路设计行业面临着加征关税和技术限制等多重制约，这无疑增加了产业链国际化拓展与升级的难度。

同时，鉴于公司的部分客户来自新加坡、韩国、中国香港等国家和地区，部分海外客户可能因贸易摩擦而短期内减少订单，这不仅会影响公司短期的营运增速，还可能对长期的国际业务开展构成一定障碍。

公司在美国、新加坡、韩国等地设有办公室，以支持其全球化业务的发展，打造国内和国际“双循环”模式。然而，若国际贸易摩擦持续升级，公司的全球化业务联动与管理能力将受到不利影响，这可能会在一定程度上削弱其全球化业务拓展和国际人才引进的能力。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023-2025年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元 币种：人民币				
项目	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)	2023年
营业收入	939,434,993.17	545,510,607.86	72.21	393,632,323.78
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	934,348,650.09	493,312,371.70	89.40	368,094,018.58
利润总额	-142,818,444.47	-298,673,685.09	不适用	-87,578,756.30
归属于上市公司股东的净利润	-113,918,566.81	-290,597,343.59	不适用	-54,184,639.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,719,680.60	-300,204,783.40	不适用	-187,281,894.01
经营活动产生的现金流量净额	-165,665,147.68	-218,484,467.40	不适用	-245,012,004.35
项目	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	1,424,570,754.60	1,478,987,485.53	-3.68	1,834,938,568.16
总资产	1,851,966,327.09	1,810,336,339.19	2.30	2,016,373,736.11

2023-2025年，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益（元/股）	-0.28	-0.74	不适用	-0.13
稀释每股收益（元/股）	-0.28	-0.74	不适用	-0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.29	-0.76	不适用	-0.46
加权平均净资产收益率（%）	-7.88	-17.59	增加9.71个百分点	-2.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-8.21	-18.17	增加9.96个百分点	-10.26
研发投入占营业收入的比例（%）	27.80	46.31	减少18.51个百分点	60.32

2025年，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、2025年度，公司实现营业总收入人民币93,943.50万元，较上年同期上升72.21%；2025年，随着消费电子市场逐步回暖，叠加公司新品持续放量及海外市场拓展深化，终端客户需求较去年同期有所上升，公司的营业收入较上年同期实现显著增长。其中音圈马达驱动芯片产品线（即智能视觉感知业务）部分产品已逐步实现自主委外生产，使得该产品线的营收规模明显增长；此外，公司2024年8月末新增的传感器芯片产品线对公司本报告期的营收增长亦有所贡献。

2、本报告期公司利润总额较去年同期减亏15,585.52万元，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减亏17,667.88万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减亏18,148.51万元。随着公司总体业务规模的扩大，产品矩阵日益丰富，以及公司对上游供应链的有效整合，公司毛利润较去年同期有所增加。同时，随着市场逐步回暖，市场需求趋于稳定，存货的减值风险得到有效缓释，本报告期计提资产减值准备金额较去年同期有所减少。

3、基本每股收益、稀释每股收益同比增加0.46元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益较上年增加0.47元/股，加权平均净资产收益率以及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年分别增加9.71个百分点和9.96个百分点，主要系归属于上市公司股东的净亏损以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损缩窄所致；研发投入占营业收入比例下降约18.51个百分点，主要系本年营业收入增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）核心技术情况

凭借创始团队在模拟芯片领域的深厚积累以及核心技术团队持续研发，公司通过自主研发的方式形成了具备较强行业竞争力的核心技术体系，在各系列主要产品中发挥了至关重要的作用。截至报告期末，公司拥有 10 项主要核心技术，均为自主研发，每项核心技术均已申请知识产权保护，具体如下表所示：

序号	核心技术类别	技术来源	技术简介	应用场景
1	高性能 DC/DC 变换技术	自主研发	创新的迟滞式控制方式以实现快速的负载动态响应、高效率、低纹波、控制模式间平稳切换等技术指标	智能手机等消费电子
2	锂电池快充技术	自主研发	以高效开关式充电及混合快充电路拓扑覆盖锂电池充电周期中变化的快充需求	可穿戴设备等消费电子
3	电荷泵超级快充技术	自主研发	实现高效率、高可靠性的电荷泵降压拓扑及其对应的驱动和保护电路技术	智能手机等消费电子
4	高性能 AC/DC 变换技术	自主研发	包括高性能的交流直流变换拓扑和对应的闭环控制方法、漏源电压检测方法以及功率因数矫正技术等	智能手机、笔记本电脑、家电等消费电子
5	高性能通用模拟集成电路模块	自主研发	多种高性能模拟集成电路模块，包括 LDO、电荷泵、A/D 转换、电流检测、乘法器、驱动电路等	消费电子、汽车电子等
6	高效和高自由度无线充电技术	自主研发	包括支持低频无线快充的多种新的接收端功率变换拓扑以及支持高自由度的高频无线充电系统架构及控制方法	智能手机、可穿戴设备等消费电子
7	车规和工规模拟集成电路技术	自主研发	包括高稳定性、安全性、可靠性的高性能功率变换及负载开关等模拟集成电路技术	汽车电子、数据中心等
8	端口保护和信号切换电路技术	自主研发	包括端口 ESD 电路保护、浪涌保护，以及负载开关防门锁等电路技术，以对信号带宽最小的影响来实现端口保护和信号切换等功能	智能手机、笔记本电脑等消费电子
9	自动对焦及光学防抖研发技术	受让、自主研发	高性能数模混合 SOC，采用 40nm 工艺，集成多种数字和模拟 IP 包括 RISC-V 控制器，SRAM，DSP，多种传感器，模拟前端（AFE），驱动器以及 I3C,SPI 等接口	智能手机和手表、平板电脑等
10	电容式多点触控技术	自主研发	触摸控制器集成电路，通过手指触摸改变电容量来检测和识别每个接触扇区，从而控制屏幕触摸操作，在触摸控制器集成电路中将电容量转换为电流或电压形式	智能手机、可穿戴设备、笔记本电脑

注：上述第 10 项核心技术系公司控股子公司 Zinitix 自主研发的核心技术。

（二）核心技术先进性

公司目前的核心技术主要聚焦在电源管理芯片及信号链芯片等模拟集成电路及高性能数模混合 SOC 领域，在产品高效率、高精度、高集成度、抗干扰等方面具备

较为领先的技术地位，即能够使公司主要产品基本具备与国际龙头企业相竞争的性能。具体而言，与国内外同行业公司相比，公司基于核心技术开发的消费电子类及车载类 DC/DC 芯片、超级快充芯片、端口保护及信号切换芯片和音圈马达驱动芯片，部分产品型号在国内处于领先地位，并具备了与国际竞品相似的性能，甚至在个别技术指标上表现优于国际竞品，进入了多个全球一线手机品牌及中国、欧洲和日韩汽车品牌客户的供应链。因此，公司现有产品的技术水平在国内处于领先地位，在国际范围内也具备与国际龙头企业相竞争的实力。

（三）报告期内变化情况

公司通过自主研发的方式形成的主要核心技术，构建了电源管理芯片及信号链芯片等模拟集成电路领域的创新性技术体系。报告期内，公司持续在电源管理芯片及信号链芯片等模拟集成电路领域进行技术拓展，并获得了多项相关专利授权，多款高性能模拟芯片性能持续提升。公司的核心技术深度融合于 DC/DC 芯片、超级快充芯片、锂电池快充芯片、端口保护、信号切换芯片及音圈马达驱动芯片等消费类和车规及工规芯片产品设计中，奠定了其产品国内领先的技术地位，并实现了产业化落地，并结合客户需求不断完成产品迭代升级。

凭借早期在 AI 与算力电源领域的前瞻性战略布局与新技术预研，公司积累了深厚的技术和国内外专利储备，为新一代应用于 AI 硬件产品的电源芯片成功落地提供了坚实支撑，展现了公司在前沿技术领域的敏锐洞察力与布局能力。

公司于 2022 年底获得韩国动运的自动对焦和光学防抖相关专利和技术在大中华区的独占使用权。以此为契机，公司逐步组建专业的研发团队，持续推进新一代自动对焦和光学防抖芯片产品开发。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2025 年度公司研发投入为 26,116.04 万元，较 2024 年度研发投入 25,261.13 万元增长了 3.38%，主要系本年度各项研发耗材、测试以及技术服务费用增加所致。

2025 年度研发投入占营业收入的比例为 27.80%。

（二）研发进展

公司通过自主研发的方式形成的主要核心技术，构建了电源管理芯片及信号链芯片等模拟集成电路领域的创新性技术体系。报告期内，公司持续在电源管理芯片及信号链芯片等模拟集成电路领域进行技术拓展，并获得了多项相关专利授权，多款高性能模拟芯片性能持续提升。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.57 元，募集资金总额为人民币 134,313.57 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 122,140.85 万元。上述募集资金已全部到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0095 号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》。

本报告期，募集资金基本情况如下：

单位：人民币元

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 1 月 17 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,343,135,700.00
其中：超募资金金额	639,718,426.25
减：直接支付发行费用	121,727,173.75
二、募集资金净额	1,221,408,526.25
减：	

以前年度已使用金额	594,199,267.44
本年度使用金额	292,561,715.57
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-节余募集资金用于永久补充流动资金	3,042,059.54
加：	
募集资金利息收入	40,924,156.01
其他-自有资金支付发行费用	11,190,382.11
三、报告期期末募集资金余额	383,720,021.82

经核查，保荐机构认为希荻微 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 12 月 31 日，希荻微控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

单位：股

股东类型/职务	股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或 冻结情况
实际控制人	戴祖渝	/	93,790,457	22.74	/	/
实际控制人、董事、 副总经理、 董事会秘 书、财务负 责人	唐娅	/	58,864,836	14.28	/	/

实际控制人、董事长、核心技术人员、总经理	TAOHAI（陶海）	/	/	/	/	/
董事、核心技术人员、副总经理	范俊	-3,000,000	10,049,225	2.44	/	/
董事、核心技术人员、副总经理	郝跃国	/	10,153,580	2.46	/	质押 10,150,000 股
董事	李程锦	/	/	/	/	/
董事会秘书、财务负责人、董事	卢海航	/	/	/	/	/
独立董事	徐克美	/	/	/	/	/
独立董事	黄澄清	/	/	/	/	/
独立董事	王一鸣	/	/	/	/	/

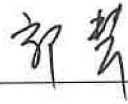
注：公司于4月23日出具了《希荻微电子集团股份有限公司关于原实际控制人股份继承过户的进展公告》。根据公告原实际控制人之一戴祖渝女士于2025年5月逝世，戴祖渝女士生前直接持有公司股份93,790,457股，2025年8月25日，经广东省深圳市先行公证处公证，上述股份全部由其长子暨公司实际控制人之一TAOHAI（陶海）先生继承。鉴于股份继承过户登记手续所需的相关文件及所涉及的费用仍在准备和筹措过程中，办理周期和程序比预期较长和繁杂，截至本核查意见披露之日，上述股份继承过户尚未办理完成。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(以下无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



郭慧



陶木楠

中国国际金融股份有限公司

